La memoria del ordenador



IES Gonzalo Nazareno
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Alberto Molina Coballes David Sánchez López

Fundamentos de Hardware

Diciembre 2011

La memoria

- Desde el punto de vista informático, memoria es todo dispositivo que es capaz de:
 - Almacenar información
 - Suministrar información

Operaciones básicas de memoria

- Por tanto, las operaciones básicas que va a permitir una memoria son:
 - Lectura: el dispositivo de memoria suministra información previamente almacenada
 - Escritura: el dispositivo de memoria almacena una información en un lugar disponible

Aspectos de diseño

- Existen multitud de tecnologías para la fabricación de memorias, pero todas ellas trabajan sobre los mismos aspectos de diseño:
 - Coste
 - Capacidad de almacenamiento
 - Tiempo de acceso
 - Tiempo de ciclo
 - Ancho de banda o transferencia

Jerarquía de memoria de un ordenador

- Las distintas memorias de un ordenador se organizan en niveles, desde las más pequeñas y rápidas hasta las más lentas y de mayor capacidad:
 - Registros de la CPU
 - Memoria caché (L1, L2 y L3)
 - Memoria principal (RAM)
 - Memoria secundaria (HDD)
 - Memoria auxiliar (lápices USB, discos en red)
- Este conjunto de niveles se denomina Jerarquía de Memoria

Relación tamaño - velocidad - precio

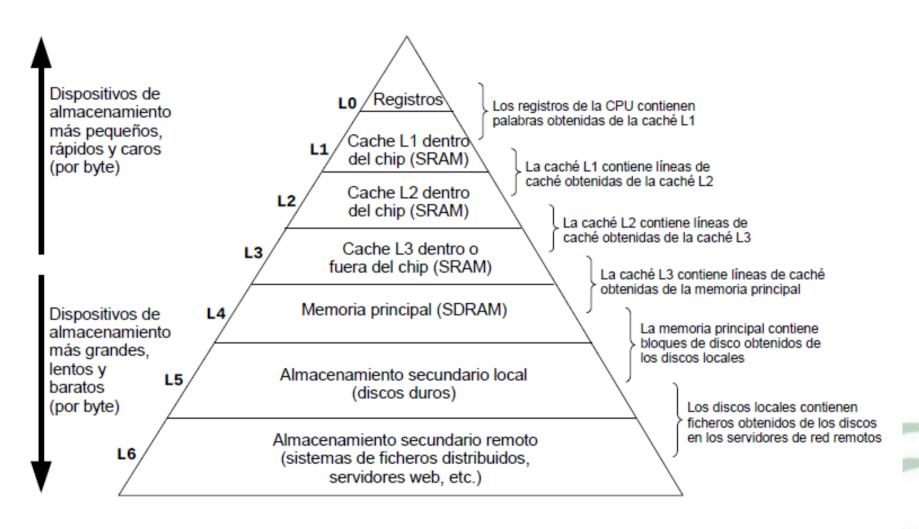


Figura: Estructura básica de la jerarquía de memoria.

- Volatilidad
 - Memoria volátil
 - Memoria no volátil
- Tipo de acceso a los datos
 - Secuencial
 - Aleatorio
- Material de fabricación
 - Memorias magnéticas
 - Memorias de semiconductores
 - Memorias ópticas
 - Memorias mixtas

Dinámicas o estáticas

- Dinámicas: necesitan que la información almacenada sea refrescada cada cierto tiempo.
- Estáticas: no necesitan de refresco.

Síncronas o asíncronas

- Asíncronas: no utilizan ningún reloj que marque la cadencia para que el dato sea leído o escrito.
- Síncronas: requieren de un reloj que marque las pautas de lectura o escritura de los datos.

Tiempo de ciclo

 Determina el intervalo que debe transcurrir entre dos refrescos sucesivos

Latencia

Es el tiempo que transcurre desde que la memoria recibe la orden de leer o escribir un dato, hasta que éste se incorpora al bus de datos o pasa del bus de datos a la celda correspondiente

Velocidad (frecuencia)

 Número de operaciones por segundo que puede realizar la memoria

Ancho de banda (tasa de transferencia)

Cantidad de datos que la memoria puede recibir o entregar por segundo. Se mide en bytes/s.

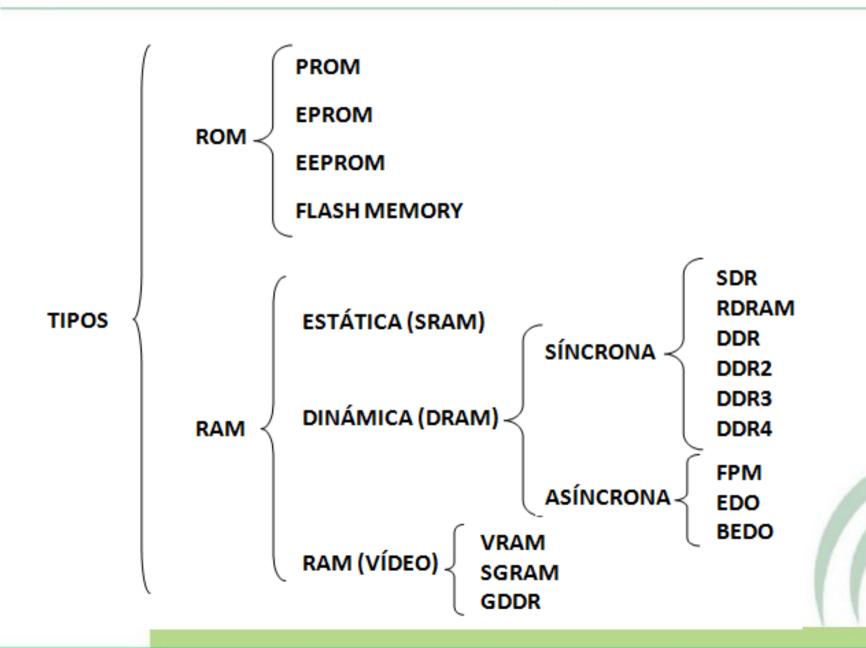
Capacidad

 Cantidad de información que puede almacenar. Se mide en bytes (mega, giga, etc).

Memorias de semiconductores

- Se basan en materiales semiconductores y la tecnología de los circuitos integrados
- Se distinguen dos tipos principales:
 - ▶ De lectura y escritura → Memorias RAM
 - ▶ De solo lectura → Memorias ROM

Tipos de memoria de semiconductores



- SIMM (Single In-line Memory Module)
 - Módulos de 30 contactos



Módulos de 72 contactos



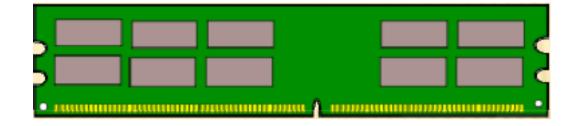
DIMM (Dual In-line Memory Module)

- Son capaces de transferir 64 bits de datos en cada ciclo de reloj
- Existen dos versiones para portátiles: SO-DIMM y Micro-DIMM.

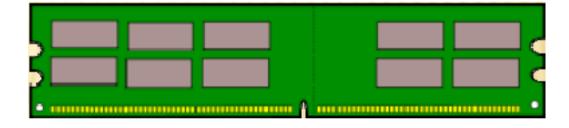
Algunos tipos comunes de DIMM:

- SO-DIMM de 200 contactos → DDR
- SO-DIMM de 200 contactos → DDR2
- SO-DIMM de 204 contactos → DDR3
- DIMM de 184 contactos → DDR
- DIMM de 240 contactos → DDR2
- DIMM de 240 contactos → DDR3

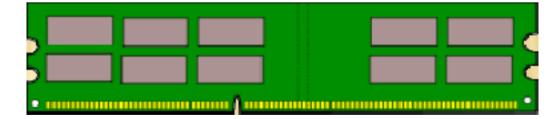
DDR



DDR2

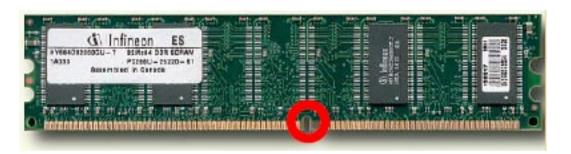


• DDR3



¡Todos son incompatibles entre sí, incluso DDR2 y DDR3 aún teniendo el mismo número de pines!

• DIMM 184 (DDR)



DIMM 240 (DDR2)



• DIMM 240 (DDR3)



SO-DIMM DDR



SO-DIMM DDR2



SO-DIMM DDR3



RIMM (Rambus In-line Memory Module)

- Módulos de 168 contactos y 64 de ancho de bus
- Trabaja con chips de memoria Rambus (apareció con P4)
- Altas frecuencias de trabajo → requieren disipadores de calor (placa metálica que recubre los chips del módulo)
- Todos los zócalos de un banco deben estar ocupados y si no, habrá que instalar un módulo de continuidad para cerrar el canal



- Comparación del aspecto físico de los distintos módulos de memoria
 - SIMM de 30 contactos
 - SIMM de 72 contactos
 - DIMM de 168 contactos
 - DDR de 184 contactos
 - RIMM de 184 contactos









Zócalos de memoria

- Lugares donde se insertan los módulos de memoria
- Se agrupan en bancos de uno, dos, cuatro y hasta 6 zócalos numerados como SIMM1, SIMM2, etc. (o DIMM1, DIMM2, etc.)



Características específicas

- Sin embargo, existen otras características específicas que también son muy importantes como:
 - Dual-Channel
 - Tri-Channel
 - Latencia CAS o CL
 - > ECC
 - Buffered and Unbuffered Memory

Características específicas

Dual Channel/Tri Channel

- Permite a la CPU trabajar con dos/tres canales independientes y simultáneos para acceder a memoria principal.
- Las mejoras de rendimiento son especialmente perceptibles cuando se trabaja con la tarjeta de vídeo integrada en la placa base.
- Las TriChannel se usan con los Core i7 y en algunos Xeon de servidores.

Latencia CAS

Indica el tiempo que transcurre desde que el controlador de memoria envía una petición para leer una posición de memoria hasta que los datos son enviados a los pines de salida del módulo.

Características específicas

ECC (Error Checking and Correction)

- Todas las memorias RAM experimentan errores.
- Las mémorias ECC son capaces de detectar y corregir dichos errores pero no todas las placas base las soportan.

Buffered and Unbuffered Memory

- Los módulos de memoria buffered o registered RAM son aquellos que tienen unos registros intermedios entre el controlador de memoria y la propia memoria.
- Son más estables, algo más lentas y más caras que las unbuffered y suelen incorporar ECC.
- Se usan principalmente en servidores.